

第43回 先進企業見学・研修会

- 開催日：2019年(令和元年)6月19日(水)
- 見学先：・アピックヤマダ株式会社(千曲市上徳間90)
・株式会社竹内製作所(坂城町上平205)
- 集合・帰着：8:30 集合 8:35 発信州大学繊維学部正門前 (AREC帰着予定 16:15頃)
- 定員：40名 (参加を希望される方が多数の場合は1社2名とさせていただきます)
- 申込締切：5月31日(金)(両社様用に参加者名簿提出のため)
- 持物：名刺・筆記用具
- 行程：全行程貸切バス
- 当日連絡先：080-8836-3120 当日はこちらの番号にご連絡願います。
- 主催：(一財)浅間リサーチエクステンションセンター・東信州次世代産業振興協議会
- 後援：八十二銀行、上田信用金庫、商工組合中央金庫、長野県信用組合、長野銀行(連携協定金融機関5行)

■スケジュール■ 信州大学繊維学部発(8:35) = アピックヤマダ着(9:20) = アピックヤマダ(株)見学(9:30-11:30) = 同出発(11:40) = 白鳥園着(11:50) 昼食 = 同出発(12:40) = 竹内製作所着(13:10) = (株)竹内製作所見学(13:30-15:30) = 同発(15:40) = 信州大学繊維学部着(16:15頃) = 名刺交換交流会 ARECにて(16:30~17:30)
*今回の見学会は時間的に余裕がありますので、AREC 帰着後参加された方々同士の親睦を目的として、名刺交換交流会を開催する予定です。(但し、交流会への参加希望者が少ない場合は開催いたしません)

アピックヤマダ株式会社

当社は、日本で初めて半導体用モールドイング金型を自社開発・製造・販売した企業です。モールドイングとは半導体組立の後工程に位置し、半導体素子を保護するために樹脂で封止する技術です。当初、金型製作から創業した当社ですが、半導体需要拡大と共に半導体組立メーカー等から量産用の自動設備の開発要求が活発になり、当社の金型を搭載する自動装置を開発しました。その後は、モールドイング後の工程の設備も製品ラインナップに揃えて事業を拡大して参りました。市場動向を見極め、半導体の世代交代、および、新技術に対応した金型・装置の開発にも積極的に取り組み、将来を見据えた新たな取り組みとして、車載半導体、LED成形機、ICタグ等の新規部品事業を手がけております。2019年2月には、お客様である半導体組立メーカーの事業規模の拡大と要求の高度化に 대응するために、表面実装機と産業用ロボット事業のヤマハ発動機、およびボンディング装置の新川との事業統合を発表し「半導体後工程におけるターンキープロバイダーとして、お客様の期待を超えるトータルソリューションを提供する」ことを目的として、更なる発展を目指して動き始めております。

株式会社竹内製作所

当社は、建設機械の完成品メーカーです。大規模なインフラ建設用途の大型ショベル機しかなかった1971年、大手メーカーに先駆けて世界初のミニショベルを開発。住宅工事、下水工事、ガス管工事などの小規模な都市工事における「作業員のツルハシ代わり」として重宝され、独自市場を創造しました。1986年には世界初のクローラーローダーを開発。それ以後も、多くの「世界初」を創造してきました。当社の大きな特徴としては、製品開発の全てを国内で行い、生産についても欧米向け製品を中心にほとんど全てを国内で行う一方で、連結売上高の97%を海外で獲得するグローバルな事業展開を行っていることです。たとえ地球の裏側に現場があろうとも、その現場ニーズをつぶさに取り入れたマーケットインの製品開発にこだわり、Made in Japanの高品質な製品を全世界に向けて提供しています。こうした当社の取り組みは、欧米での高いシェアに結びついています(欧州：第2位、北米：第5位 Off-Highway Research 社調べ：2018年)。

●お申込先 AREC・Fi i プラザ事務局 宛
メール(mousikomi@arecplaza.jp)またはファックス(0268-21-4382)でお申し込みください。

※ 当日受付後、ネームホルダーをお配りしますので、名刺を入れ、見学時は装着ください。

AREC・Fi i プラザ 第43回先進企業見学・研修会 参加申込書 【令和元年6月19日】

企業名			
参加者名	★名刺交換交流会(どちらかに☑して下さい) □出席 □欠席		
所属・役職			
当日の朝、連絡が取れる番号	★昼食(どちらかに☑して下さい) □和食 □洋食		
メールアドレス			

●ご記入いただいた個人情報(御社名・所属/役職・氏名)は参加者名簿として、訪問先企業、参加者の方々に配布する予定です。